

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-028

神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向金融机构 申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、融资授信情况概述

为了满足神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司 2023 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币 69,000.00 万元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体情况如下：

1. 公司及子公司拟向各银行申请的融资额度详见下表：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国农业银行玉立支行	29,000.00
2	中国工商银行余姚支行	30,000.00
3	宁波银行江南支行	10,000.00
合计		69,000.00

2. 公司及子公司拟向上述银行及其他融资机构申请的融资额度总计不超过人民币 69,000.00 万元，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

3. 本次公司及子公司申请融资的授权自第二届董事会第十七次会议审议通

过之日起一年有效，公司拟授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。

二、 履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》，批准相关授信融资事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。授权期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年有效。在授信额度及期限内，授权公司董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、神通科技集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日